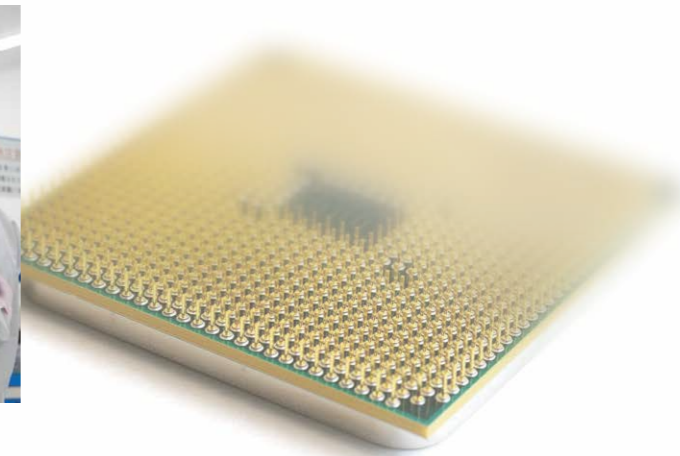


ナノメートルの技術に次の驚きを



世界トップレベルの成膜技術を軸に、高品質な半導体製造装置を生産。

半導体は、シリコンで作られたウェーハと呼ばれる基板の表面に何層もの膜を重ねて回路を形成したものです。この薄い膜を形成する工程をサーマルプロセスといい、半導体形成において、もっとも重要な工程です。私たちKOKUSAI ELECTRICは、物理的限界値に近い10ナノメートルの微細加工技術をはじめとした世界トップレベルの成膜技術を活かした半導体製造装置を生産し、世界のトップメーカーに納入。半導体の高機能化、高性能化を支えています。



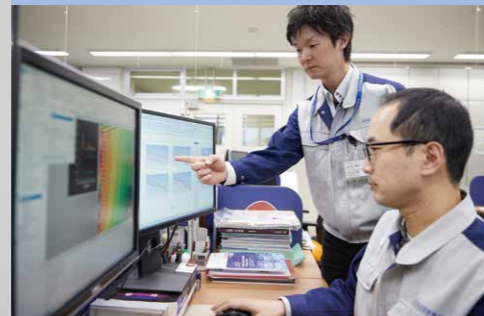
研究開発

自社の要素技術に加え、各研究機関と共同で次世代の高機能半導体技術の開発と、それを実現するための成膜技術、製造技術の開発を行っています。



設計

3DCADによる設計、流体シミュレーションなど先進技術を導入。自社の要素技術を最大限に活かし、お客様の声を製品に反映する装置の設計を行っています。



調達

装置の機種や仕様により必要な部品の種類や数はそれぞれ異なります。各地のビジネスパートナーから集められた1万5千点を超える部品を自動倉庫で管理しています。



製造

クラス5000のクリーンルームで多岐にわたる製品を製造しています。ユニット組立では、セルステーション生産方式を採用し、作業の効率化、安全性及び生産性の向上、生産スキームの最適化を推進しています。



出荷

すべての工程において、厳密な製品検査と出荷検査を実施。完成した装置は、環境にも配慮した輸送方法で世界へと出荷されます。



搬入・セットアップ

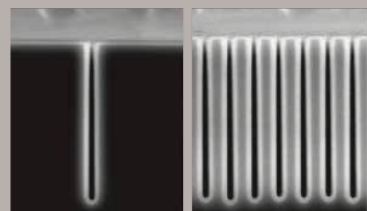
お客様の工場へ出向き、お客様の納期にあわせ、装置の搬入から組立、配線、試験・調整、プロセス立上げ作業を実施。約90%がアジアを中心とした海外のお客様であり、多くの社員が海外で活躍中です。



薄膜形成プロセス技術

BCD®(Balance Controlled Deposition)は、当社独自の次世代の新成膜ソリューションです。このBCD®技術により、次世代半導体プロセスに要求される低温処理、微細加工対応、高生産性を高次元で両立することが可能となり、幅広いアプリケーションへの展開が可能となります。

優れた段差被膜性



※BCDは株式会社 KOKUSAI ELECTRIC の日本における登録商標です。

主要製品

バッチプロセス装置



高品質成膜・高性能半導体製造装置
TSURUGI-C² 鋺®



高生産性縦型装置
AdvancedAce®-300



200mmウェーハ対応
バッチサーマル
プロセス装置

枚葉プロセス装置



枚葉プラズマ酸化・酸化装置
MARORA®



枚葉キュア・アニール装置
TANDUO®



枚葉アッシング装置
Lambda300

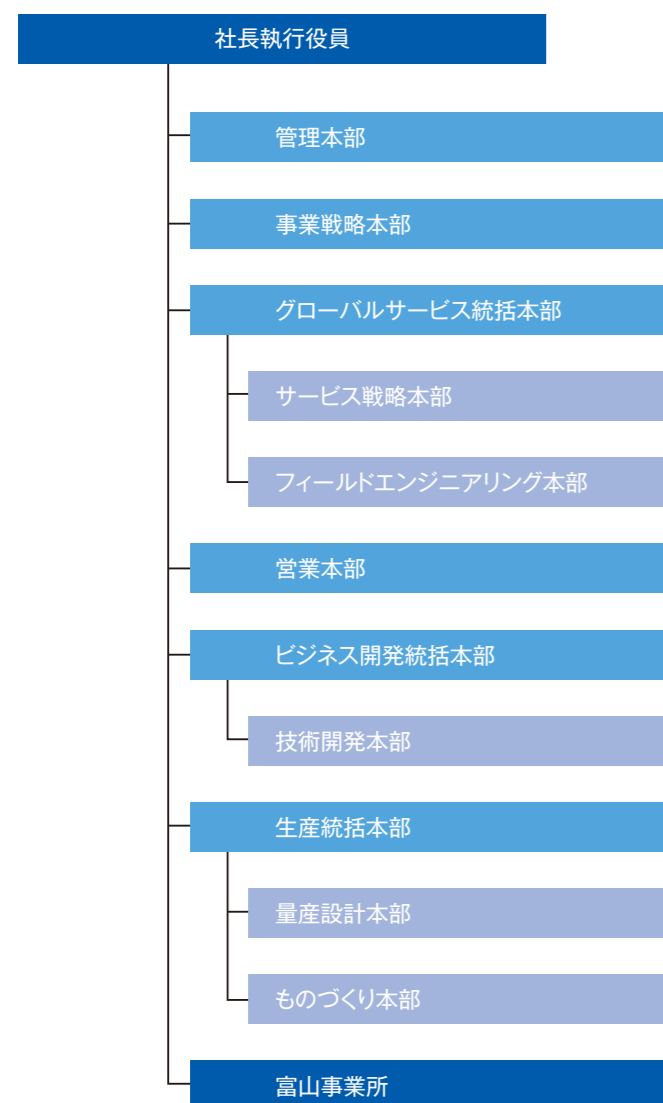
※TSURUGI-C²、鋺のロゴ、AdvancedAceは株式会社 KOKUSAI ELECTRIC の登録商標です。

※MARORA、TANDUOは株式会社 KOKUSAI ELECTRIC の登録商標です。

会社情報

社名 株式会社KOKUSAI ELECTRIC
設立 2017年2月2日
本店所在地 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
代表者 代表取締役 社長執行役員 金井 史幸
資本金 1億円
事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで
従業員数 968名(個別)
 (2019年3月31日時点) 1,897名(連結)
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人

組織図



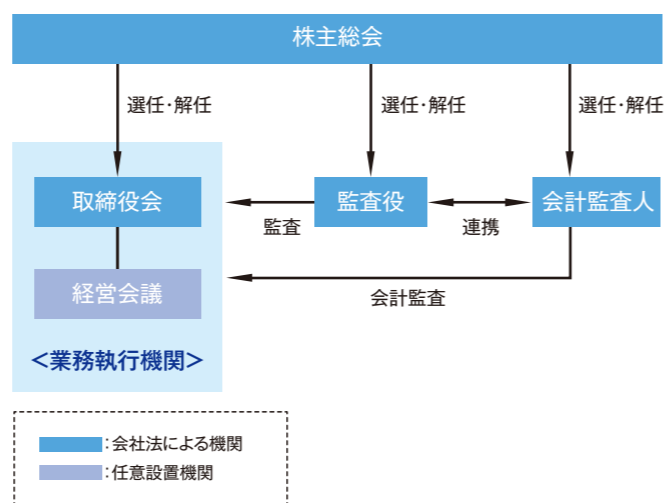
取締役、監査役及び執行役員

■取締役
 代表取締役 金井 史幸
 取締役 神谷 勇二
 取締役(非常勤) 近藤 博昭
 谷田川 英治
 中村 正樹

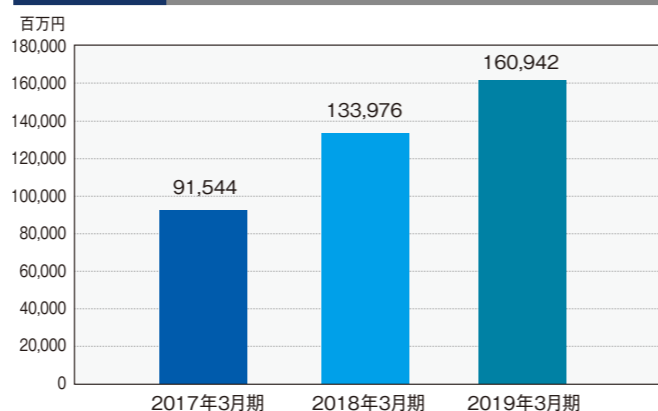
■監査役
 監査役 村川 盛雄

■執行役員
 社長執行役員 金井 史幸 業務執行の統括
 専務執行役員 神谷 勇二 管理部門、倫理・コンプライアンス、
 情報セキュリティ担当
 常務執行役員 小川 雲龍 技術開発、ビジネス開発担当
 執行役員 柳川 秀宏 製品開発、生産・品質保証担当
 塚田 和徳 営業担当

コーポレートガバナンス

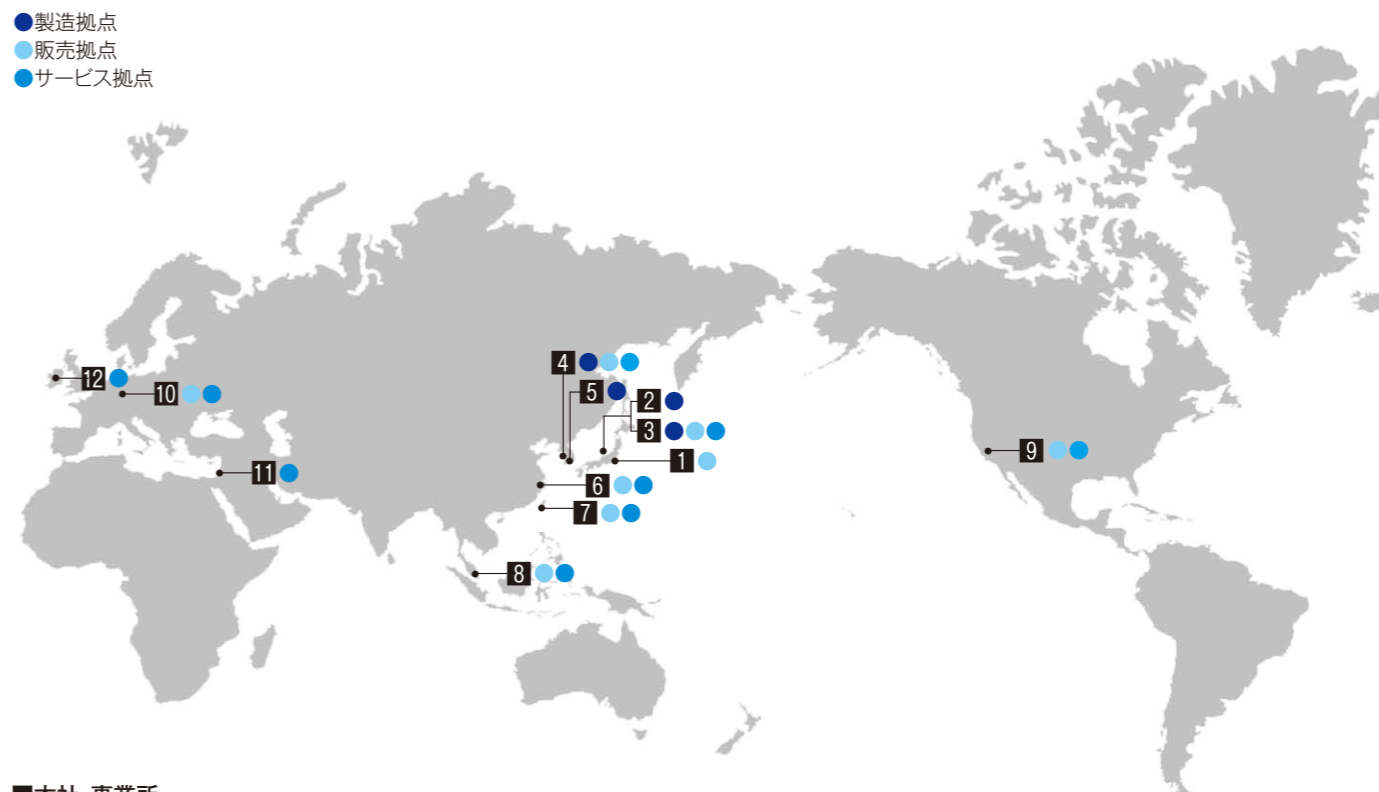


売上高(連結)



注)本数値は未監査の参考値です。
 売上高は4月1日から3月31日までを1会計期間として記載しています。
 2019年3月期は日本基準により計算、過年度分は国際財務報告基準(IFRS)に基づいて計算、表記しています。

事業拠点・グループ企業



■本社・事業所

本社
1 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4
 TEL.03-5297-8530

富山事業所
2 〒939-2393 富山県富山市八尾町保内2-1
 TEL.076-455-9111

■国内グループ会社

株式会社国際電気セミコンダクターサービス
3 〒939-2393 富山県富山市八尾町保内2-1
 TEL.076-454-5931

■海外グループ会社

(アジア)
Kook Je Electric Korea Co., Ltd.
4 (Chaam-dong) 46, 2gongdan 8-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungnam 31075, Korea
 TEL.+82-41-559-1705

5 64, Jinwisandan-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17709, Korea
 TEL.+82-31-8015-8300

KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
6 Room ABJ, 22F World Plaza, No.855 Pudong Road South, Pudong New Area, Shanghai 200120, China
 TEL.+86-21-6888-1166

Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.
7 9F, No.282 Beida Road, Hsin Chu City, Taiwan 300
 TEL.+886-3-528-5788

8 31 Tannery Lane, #03-01 HB Centre II, Singapore 347788
 TEL.+65-6848-2633



(北米)
Kokusai Semiconductor Equipment Corporation
9 2460 North First Street, #290, San Jose, CA 95131, U.S.A.
 TEL.+1-408-456-2750

(欧州)
Kokusai Semiconductor Europe GmbH
10 Gruitener Strasse 3, D-40699 Erkrath, Germany
 TEL.+49-2104-9655-0

11 Intel, M.S. LCS2-3S, Shderot Ha-Avatz Str. P.O.Box 1000, Kiryat Gat 82109, Israel
 TEL.+972-8612-3791

12 Unit H9, Maynooth Business Park, Maynooth, Co. Kildare, Ireland
 TEL.+353-1-606-8487